

# tesa<sup>®</sup> HAF 8440

## Termék Információk



40 µm átlátszó HAF rögzítőszalag

## Termékleírás

### Jellemzők

- Megbízható chip-modul ragasztás
- PVC, ABS és PC kártyákhoz alkalmas
- Jó kezelhetőség minden általános beültető soron
- Jó öregedésállóság
- Összeszerelt kártyán láthatatlan

### Alkalmazások

A tesa HAF<sup>®</sup> 8440 kifejezetten chip-modulok okoskártyákba történő beágyazására lett tervezve.

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                |                    |          |
|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga        | egyáltalán nem | • Liner típusa     | pergamen |
| • Ragasztóanyag típusa | kopoliamid     | • Teljes vastagság | 40 µm    |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Kötési szilárdság (dinamikus nyírás) | 12 N/mm <sup>2</sup> |
|--|----------------------|

### Kiegészítő információk

Műszaki ajánlások:

Az alábbi értékek a gép paramétereinek javasolt beállításai a kezdéshez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az optimális paraméterek nagymértékben függenek a géptípustól, a kártyatestek és chip-modulok konkrét anyagaitól, valamint az ügyfél igényeitől.

#### 1. Előlaminalás:

Az előlaminalás során a ragasztószalagot rálaminálják a modul szalagra. Ez a lépés történhet online vagy offline módon. Az előlaminalás lépése nem befolyásolja a ragasztószalag eltarthatóságát.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=8440>

# tesa<sup>®</sup> HAF 8440

## Termék Információk

### Kiegészítő információk

#### Gépbeállítás:

- Hőmérséklet: 130-140 °C
- Nyomás: 2-3 bar
- Idő: 2,5 m/perc

#### 2. Modul beágyazás:

A modul beágyazás során az előlaminált modulokat kivágják a modul szalagról, elhelyezik a kártya üregében, majd hővel és nyomással véglegessé ragasztják a kártyatesthez. Ennél a lépésnél a pontos kezelés az alkalmazott beültető sor típusától függ. Egy lépéses vagy többlépéses eljárás is használható. Manapság a többlépéses eljárás az általános:

#### Egy lépéses folyamat - Gépbeállítás:

- Hőmérséklet<sup>1</sup>: 180–220 °C
- Nyomás: 65-75 N/modul
- Idő: 1,5 s

#### Többlépéses folyamat (2 vagy több fűtőbéllyeg) - Gépbeállítás:

- Hőmérséklet<sup>1</sup>: 180–220 °C
- Nyomás: 65-75 N/modul
- Idő: 2 x 0,7 s / 3 x 0,5 s

<sup>1</sup> Hőmérséklet a fűtőbéllyegen mérve. Különböző kártyaanyagok esetén eltérő hőmérséklet beállítás javasolt:

\*PVC: 180-190 °C

\*ABS: 180-190 °C

\*PC: 200-220 °C

Chip modul beültetéstől eltérő alkalmazásoknál más gépparamétereket kell használni.

A ragasztószilárdsági értékeket szabvány laboratóriumi körülmények között mértük. Az értéket minden gyártási tételben garantált határértékként ellenőrizzük (Anyag: maratott alumínium próbatest / Ragasztási feltételek: hőmérséklet = 120 °C; nyomás = 10 bar; idő = 8 perc)

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=8440>

# tesa<sup>®</sup> HAF 8440

## Termék Információk

## Kiegészítő információk

Tárolási körülmények a tesa HAF<sup>®</sup> eltarthatósági koncepciója szerint.

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=8440>